

公司代码：603986

公司简称：兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），预计派发现金红利总额为 121,992,829.18 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.10%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 128,413,504 股，转增后公司股本变更为 449,447,265 股。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本 321,033,761 股计算，实际派发现金红利总额、资本公积转增股本数量将以 2019 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。公司 2019 年利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兆易创新	603986	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	王中华
办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大 厦A座12层	北京市海淀区学院路30号 科大天工大A座12层
电话	010-82263369	010-82263369
电子信箱	investor@gigadevice.com	investor@gigadevice.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务

公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售，其中传感器业务来自于 2019 年公司收购上海思立微电子科技有限公司（Silead Inc.）。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6550），细分行业为闪存芯片、微控制器芯片及传感器芯片设计行业。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

2、主要产品及用途

公司主要产品分为闪存芯片产品、微控制器产品以及 2019 年新增加的传感器产品。

公司闪存芯片产品主要为 NOR Flash 和 NAND Flash 两类。

1) NOR Flash 即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及少量数据。公司 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、人工智能、物联网、穿戴式设备、汽车电子等。

2) NAND Flash 即数据型闪存芯片，分为两大类：大容量 NAND Flash 主要为 MLC、TLC 2D NAND 或 3D NAND，擦写次数从几百次至数千次，多应用于大容量数据存储；小容量 NAND Flash 主要是 SLC 2D NAND，可靠性更高，擦写次数达到数十万次以上。公司 NAND Flash 产品属于 SLC NAND，广泛应用于网络通讯、语音存储、智能电视、工业控制、机顶盒、打印机、穿戴式设备等。

公司微控制器产品（Micro Control Unit，简称 MCU）主要为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 产品，以及于 2019 年 8 月推出的全球首颗基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品。GD32 作为中国 32 位通用 MCU 领域的主流产品，以 24 个系列 320 余款产品选择，覆盖率稳居市场前列，产品广泛应用于工业和消费类嵌入式市场，适用于工业自动化、人机界面、电机控制、光伏逆变器、安防监控、智能家居家电及物联网等领域。

传感器主要产品包括电容触控芯片、指纹识别芯片，广泛应用于新一代智能移动终端的传感器模组，也适用于工业自动化、车载人机界面及物联网等需要智能人机交互解决方案的领域。

（二）经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看，主要分为 IDM 模式（企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节）和 Fabless 模式（无晶圆生产线集成电路设计模式，即企业只进行集成电路的设计和制造，将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成）两种。公司作为 IC 设

计企业，自成立以来一直采取 Fabless 模式，专注于集成电路设计及最终销售环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。

从集成电路整体产业链来看，集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节，成品销售则是控制销售渠道、客户资源及品牌的销售服务环节，均在产业链中具有核心及主导作用，是 IC 设计行业的原始创新的体现和创造价值的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节，在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

从销售模式看，公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下，公司与客户直接签署销售合同（订单）并发货；经销模式下，公司与经销商签署经销商协议，由公司向经销商发货，再由经销商向终端客户销售，在此模式下，采取卖断式销售。

（三）公司所属行业发展状况以及公司所处的行业地位分析

1、行业发展状况

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。根据中国半导体行业协会统计，2019 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 5049.9 亿元，同比增长 13.2%。其中，设计业销售额为 2122.8 亿元，同比增长 18.5%；制造业销售额为 1320.5 亿元，同比增长 15.1%；封装测试业销售额 1606.6 亿元，同比增长 5.5%。根据中国半导体行业协会设计分会统计，2019 年我国集成电路设计行业发展良好，销售总值保持增长，预计达到 3084.9 亿元，较 2018 年增长 19.7%。根据中国海关统计数据，2019 年中国集成电路进口金额 3055.5 亿美元，同比下降 2.1%；集成电路进口数量 4451.3 亿个，同比增长 6.6%。2019 年中国集成电路出口金额 1015.8 亿美元，同比增长 20.1%；集成电路出口数量 2187 亿个，同比增长 0.7%。

集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业。2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议政府工作报告中，集成电路被列入加快制造强国建设需推动的五大产业首位。根据《中国制造 2025》规划目标，到 2020 年集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，半导体产业自给率达到 40%。自 2016 年以来，国内开始出台了大量政策，包括中央、地方促进第三代半导体产业的发展。在国家集成电路产业投资基金之外，十几个省市也已成立地方性产业基金。目前集成电路已经成为中国第一大进口商品，每年进口额超过 2000 亿美金，在当前中美贸易摩擦的情形下，集成电路产业国产替代大有可为。

2、公司产品细分领域情况

随着集成电路行业的快速发展，应用场景的不断扩展，以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现，集成电路产品的市场需求不断扩大。全球知名研究机构 IHS Markit 预测，2020 年全球半导体市场营收将实现 5.9% 的增长，其中主要的增长动力将来自 5G 手机的大幅增长。

细分到闪存产品市场，根据伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)统计，2019 年全球 NAND Flash 市场预计总营收同比下降 30%，约为 420 亿美元，预计 2020 年全球对 NAND Flash 产品的需求开始回升，企业级 SSD 和智能手机成为两大主力需求。NOR Flash 闪存方面，根据 Morgan Stanley 研究报告评估，预计 2020 年 NOR Flash 全球营收较 2019 年相比将迎来 3% 的增长，随着物联网的普及、5G 基站建设、汽车智能化的不断推进，以及 TWS 耳机功能的日益增多，NOR Flash 产品将有望迎来更多增量需求。

细分到 MCU 产品领域，IC insights 报告指出，2019 年 MCU 营收较 2018 年预计下降 5.8% 至 165 亿美元，全球 MCU 单位出货量从 2018 年的 281 亿颗下降至 269 亿颗。估计到 2020 年，MCU 市场在经历过 2019 年的衰退后，将出现适度反弹，市场展望 2020 年 MCU 营收将增长 3.2% 至 171 亿美元，预期出货量将成长超过 7%，其中，汽车应用仍然是 MCU 产品最大的终端用户市场，预计汽车 MCU 销售额将在 2020 年上升 1% 至接近 65 亿美元。

细分到指纹传感器芯片领域，根据群智咨询 (Sigmaintell) 报告，预计 2019 年指纹传感器的出货量将达到 9.9 亿颗，同比增长约 12.5%。光学屏下指纹方面，预计 2019 年全球光学屏下指纹的出货量进一步上调到 2.8 亿颗，同比增长约 372%。超声波指纹芯片预计 2019 年全球的出货量为 0.5 亿颗。根据 CINNO Research 屏下指纹市场报告数据显示，2019 年全球屏下指纹手机出货量约为 2.0 亿台，同比增长 614%。预估至 2024 年，整体屏下指纹手机出货量将达 11.8 亿台，年均复合增长率 CAGR 达 42.5%。

细分到 DRAM 芯片市场，CFM(中国闪存市场)年度报告指出，2019 年 DRAM 销售额达 630 亿美元，根据 SIA (美国半导体行业协会) 数据统计，与 2018 年相比，DRAM 产品 2019 年销售额下降了 37.1%。由于 PC、服务器与智能手机等终端产品需求疲软，2019 年 DRAM 产能过剩问题较为明显，因此 DRAM 主要供应商纷纷放缓新增产能，阻止内存价格下滑。根据 Bernstein Research 报告指出，2019 年到 2020 年的 DRAM 市场需求增长主要依靠手机和 Server 两大市场拉动。

3、公司所处的行业地位

公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。据 TrendForce 数据统计，按营业收入计算，

公司 2018 年保持中国 IC 设计行业收入排名前十。据 CINNO Research 对 2019 第二季度存储产业研究报告显示，公司在 NOR Flash 领域公司超越美光，以 13.9% 的市场份额首度站上全球第四名的位置；据 CINNO Research 对 2019 第三季度存储产业研究报告显示，公司 Nor Flash 市场份额提升到 18.3%，超越赛普拉斯排名全球第三，前二名分别为华邦电子和旺宏电子。依据 IHS Markit 报告，在中国 Arm Cortex-M MCU 市场,2018 年公司销售额排名为第三位，市场占有率 9.4%，前两位分别为意法半导体（STMicroelectronics）和恩智浦半导体（NXP）。依据赛迪数据，2018 年公司传感器业务（思立微）中，触控芯片全球市场份额为 11.40%，排名第四；指纹芯片全球市场份额为 9.40%，排名第三，前二位分别为汇顶科技、FPC。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	6,173,524,466.50	2,860,830,541.44	115.79	2,574,373,457.25
营业收入	3,202,917,103.20	2,245,786,322.12	42.62	2,029,708,831.51
归属于上市公司股东的净利润	606,922,090.23	405,006,415.38	49.85	397,416,022.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,580,365.48	360,929,818.56	56.70	331,518,681.54
归属于上市公司股东的净资产	5,225,477,100.07	1,897,177,498.58	175.43	1,756,488,318.74
经营活动产生的现金流量净额	967,347,203.67	619,644,515.93	56.11	197,704,223.29
基本每股收益（元/股）	2.02	1.44	40.28	1.42
稀释每股收益（元/股）	2.01	1.43	40.56	1.41
加权平均净资产收益率（%）	16.96	22.25	减少5.29个百分点	26.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	456,337,509.24	745,720,085.85	1,001,607,890.28	999,251,617.83
归属于上市公司股东的净利润	39,675,056.35	147,811,923.35	262,201,489.64	157,233,620.89
归属于上市公司股东的	31,814,618.96	127,550,404.82	235,495,545.48	170,719,796.22

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	34,269,773.35	316,355,954.19	352,863,622.2	263,857,853.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

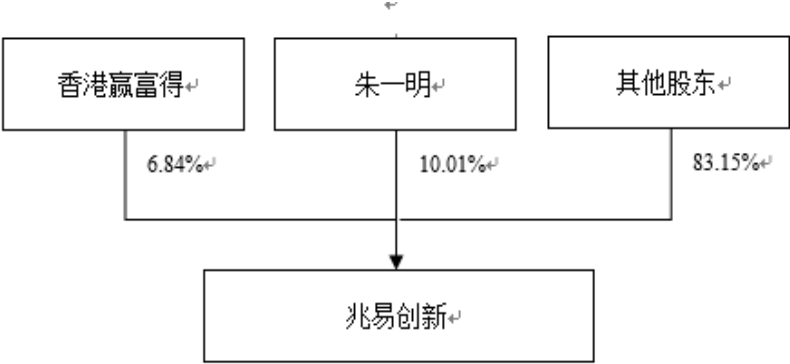
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						25,321	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						40,063	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱一明	-6,391,160	32,150,000	10.01	0	无		境内 自然 人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	31,213,000	9.72	0	无		国有 法人
InfoGrid Limited	-7,321,600	21,965,000	6.84	0	无		境外 法人
讯安投资有限公司	-8,497,681	15,648,215	4.87	0	无		境外 法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 28 号单一资金信托	0	15,081,300	4.70	0	无		国有 法人
葛卫东	11,740,198	14,390,198	4.48	5,035,112	无		境内 自然 人
聯意（香港）有限公司	11,221,541	11,221,541	3.49	11,221,541	无		境外 法人
香港中央结算有限公司	7,921,531	8,175,911	2.55	0	无		境外 法人
青岛城投股权投资管理有限公司—青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	3,611,241	3,611,241	1.12	3,611,241	无		境内 非国 有法 人
全国社保基金四零一组合	-2,699,744	3,600,272	1.12	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

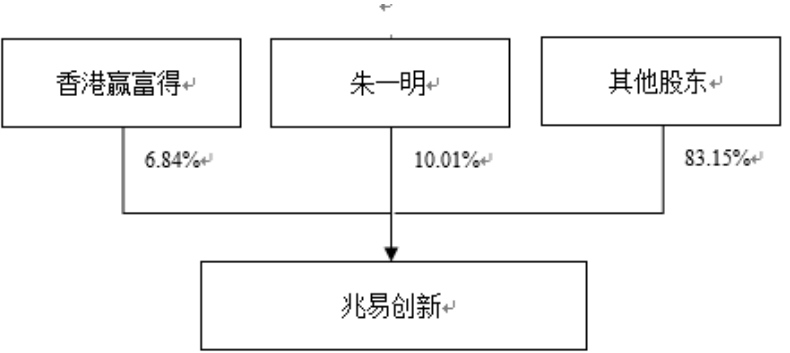
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 320,292 万元，比 2018 年同期增长 42.62%；归属于上市公司股东的净利润 60,692 万元，比 2018 年同期增长 49.85%。

1.1 优化产品线，提升竞争力

公司的现有业务布局分为存储、MCU 和传感器三大方向。

2019 年度，Flash 持续开发新产品和技术升级。(1) NOR Flash 产品，累计出货量已经超过

100 亿颗；针对物联网、可穿戴、消费类市场，推出业界最小封装 1.5mm x 1.5mm USON8 低功耗宽电压产品线；针对有高性能要求的应用领域推出了国内首颗符合 JEDEC 规范的 8 通道 SPI 产品；针对工控、汽车电子等高可靠性及高性能领域推出 256Mb、512Mb 等产品；并依据 AEC-Q100 标准认证了 GD25 全系列产品，为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。（2）NAND Flash 产品上，高可靠性的 38nm SLC Nand 制程产品已稳定量产，具备业界领先的性能和可靠性，并持续推进 24nm 制程产品进程，完善中小容量 NAND Flash 产品系列。2019 年，得益于公司 Flash 产品的技术创新，以及 TWS 耳机等驱动的 Nor Flash 产品需求增加，根据 CINNO Research 产业研究，公司 NOR Flash 全球市场份额在第二季度实现突破，上升至全球第四，并在第三季度跃居全球第三。

MCU 产品，累计出货数量已超过 3 亿颗，客户数量超过 2 万家。报告期内，公司发布基于 Arm® Cortex®-M23 内核 MCU 的最新产品，GD32E232 系列超值型微控制器。集成了片上存储器、定时器、数据转换器和众多接口外设，并提供了全新的可编程模块（CLU），提供更强的硬件灵活性、信号处理实时性，并提供更紧凑封装，新增的高集成度精密特性对于诸如光收发器、光模块、接入网等工控系统应用非常有利。公司在 2019 年内成功研发出全球首颗通用 RISC-V MCU GD32V 产品系列，创新使用 RISC-V 架构内核开发通用 MCU，并向客户提供完整的软件包、开发套件、解决方案等支持，应用覆盖物联网、工业控制、智能终端等领域，GD32V 全国产自主产品系列将为客户提供更多选择，同时也助力公司应对未来碎片化物联网应用需求。同时，公司也正在积极推进“MCU 百货商店”战略计划，陆续推出无线 MCU、电源管理芯片等全新产品系列，为客户提供丰富选择。

2019 年，公司积极推进与思立微的整合，实现优势互补。在光学指纹传感器方面，积极优化透镜式光学指纹产品，并推出 LCD 屏下光学指纹、超小封装透镜式光学指纹产品、超薄光学指纹产品、大面积 TFT 光学指纹产品，成为全行业唯一一家拥有指纹全部品类的公司。在 MEMS 超声指纹传感器研发方面也取得了阶段性进展。

1.2 持续加大研发投入

集成电路行业是技术密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动能。公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司产品的技术先进性。2019 年公司研发投入达到 3.78 亿元，占营业收入 11.8%，相比 2018 年同期增长 64.33%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时，积累了大量的知识产权专利。截止 2019 年末，在涵盖 NOR Flash、NAND Flash、MCU、指纹识别等芯片关键技术领域，公司已积累 1,195

项国内外有效的专利申请，其中 2019 年已提交新申请专利 201 项，新获得 156 项专利授权。持续的研发投入，是公司提升技术水平和产品竞争力的有力保障。

1.3 积极布局 DRAM 领域

存储芯片领域中 DRAM 等通用型产品市场规模较大，具有举足轻重的地位。公司积极整合产业资源，布局 DRAM 产品领域，进一步拓展并丰富公司产品线，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

2019 年 9 月，公司发布非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过人民币 43.24 亿元，用于 DRAM 芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。项目开发目标为研发 1Xnm 级（19nm、17nm）工艺制程下的 DRAM 技术，设计和开发 DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4 系列 DRAM 芯片。此研发项目的成功实施，将实现国内存储芯片设计企业在 DRAM 领域的突破，也有助于公司战略拓展业务领域。2019 年，公司 DRAM 项目组建了由数十名资深工程师组成的核心研发团队，涵盖前端设计、后端产品测试与验证。

公司持续推进合肥 12 英寸晶圆存储器研发项目合作。2019 年 4 月 26 日，公司与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司签署《可转股债权投资协议》，约定以可转股债权方式对项目投资 3 亿元，并继续研究商讨后续合作方案。业务方面，公司将与合肥长鑫发挥优势互补，探讨在 DRAM 产品销售、代工、以及工程端的多种合作模式。

1.4 有序推进思立微整合

2019 年 5 月，思立微产权过户手续及相关工商变更登记完成，标志着公司收购思立微 100% 股权的重大资产重组项目正式完成。公司立足已有的 Flash 业务和 MCU 业务，积极整合新加入的基于触控和指纹识别的传感器业务，推进产业整合，拓展战略布局，打造存储、控制、传感、互联、以及边缘计算的一体化解决方案来满足客户的不同需求。重组完成后，公司专门成立以董事长朱一明先生为主席的整合工作委员会，有序推进公司与思立微在业务、资产、人员、文化等方面的深度整合，协同创造价值，实现双赢合作。同时，为应对潜在的整合风险，通过加强审计监督、业务监督和管理监督，提高经营管理水平和防范财务风险。

1.4.1 人员和组织结构整合

作为公司全资子公司，思立微仍以独立法人主体存在并开展生产经营活动，经营管理团队保持相对独立和稳定，给予其较高的自主权；同时公司成立传感器事业部，整合思立微业务为公司传感器事业部，形成以存储+MCU+传感器为核心的三大事业部架构，各业务及管理部門保持高效运转。公司财务、人事行政、运营、合规法务、知识产权等职能部门进行整合，达到了良好的协

同以及管控效果。

1.4.2 业务和资产整合

在产品研发上，丰富了公司产品结构和系统解决方案，对人机交互解决方案领域进行布局，加快进入物联网、智能家居和车载电子等市场领域。在销售业务上，通过整合并共享客户渠道，支持思立微进一步拓展业务区域、提高市场占有率。在供应链方面整合，提升了晶圆厂端供货保障。在资产方面，无形资产和固定资产等纳入统一的管理体系以综合有效利用。

1.4.3 文化整合

重组完成后，公司通过引入专业咨询机构以及组织企业文化研讨会等方式，梳理、提炼企业文化，在包括思立微在内的全公司范围内组织管理培训和宣讲，提升企业文化认同感，增强公司凝聚力。

1.5 产业上下游合作及供应链管理情况

2019 年公司供应链进一步优化结构，加深与中芯国际、上海华力微电子、联华电子等国际一流大厂的合作范围与合作深度，同时与台积电的合作进展顺利。截至 2019 年年底兆易创新闪存芯片累计出货超过 100 亿颗，MCU 产品累计出货超过 3 亿颗，其中 2019 年度闪存芯片及 MCU 出货约 30 亿颗，在供应链与库存管理上积累了丰富经验。公司将引进更先进的 IT 系统，进一步提升自动化与大数据管理能力，利用科技进行供应链与库存管理的优化；并且积极与渠道合作，提升渠道库存的可控性。

1.6 准确把握市场发展，持续拓展客户

凭借多年深耕细分市场的累积和产品优势特点，公司准确把握市场发展，聚焦投入，深化各销售片区的市场开发，为客户提供全面产品线和优质服务，提升市场占有率。尤其公司在海外市场布局多年，通过和国际著名电子产品代理商的合作，加强了对国际客户的产品推广和渠道支持。2019 年，公司继续在海外业务增加人员配备，拓宽销售渠道，与著名品牌客户确立了业务合作。同时，国内及东南亚业务部门同欧美区市场配合，形成了完整的拓展和业务开发团队，为未来海外业务持续增长做好了准备。

1.7 优化组织架构，加强企业文化、人才队伍建设

2019 年，公司依据业务经营情况调整公司组织架构，组建完成了存储+MCU+传感器为核心的三大事业部架构。在部分业务领域，将销售组织进行了区域的合并，加大了协调的力度。在组织架构调整的同时，公司在落实干部年轻化方面、提炼企业文化方面开展了大量的工作。在本年度工作基础上，未来持续创新与发展，让公司能以更好的组织架构往前走，支撑公司未来的新成

长。

对于半导体公司而言，拥有人才才能拥抱未来。自成立伊始，公司就非常重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，除了持续引入具有国际视野的、有丰富行业经验和管理经验的中高层人员外，也在通过各种培养项目锻造执行团队，培养梯队人才。经过十多年的打磨，现有团队以高效务实的方式运作，保证从产品设计到产品交付的每个细节，成为公司的核心竞争力之一。截至目前，公司股权激励计划总激励对象实现了员工层面大面积的覆盖，为保留和激励员工起到了良好的效果。同时，为吸引和留住优秀海外人才，公司积极探索和推进海外员工股权激励方案。股权激励计划的顺利实施完成，充分激发了各层级员工的积极性和活力，增强了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司拥有 2 家分公司、6 家全资二级子公司、7 家全资三级子公司、1 家非全资三级子公司、1 家全资四级子公司，详见本节九“在其他主体中的权益”。

本年度新增合并范围情况如下：

2019 年 2 月本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司（以下简称“深圳外滩”）追加投资苏州福瑞思信息科技有限公司（以下简称“苏州福瑞思”），股权占比达到 84.45%，对苏州福瑞思形成控制将其纳入合并范围。而后在 4 月深圳外滩对苏州福瑞思增资 800 万人民币，股权比例提高至 88.99%，属于权益性交易，不改变合并范围。

2019 年 5 月 29 日，上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）领取了中国（上

海) 自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，上海思立微 100%的股权已变更登记至本公司名下。截止 2019 年 5 月 31 日收购标的资产的交割手续已办理完成，变更后本公司持有上海思立微 100%的股权，上海思立微变更成为公司全资控股的子公司，其附属子公司也均纳入合并范围。

2019 年 9 月 16 日,全资子公司上海思立微电子科技有限公司下在收购日后还新设了 1 家 100%控股子公司上海思芯正普软件有限公司，纳入合并范围。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日